

杭州士兰微电子股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开的公司第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司使用募集资金 1 亿元向全资子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)增资，并通过成都士兰向新增募投项目之“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”的实施主体全资孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称“集佳科技”）增资的事项。

上述事项详见公司于 2019 年 11 月 9 日和 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于调整募集资金投资项目相关事项的公告》（公告编号：临 2019-046）和《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-049）。

二、本次增资的子公司的基本情况

（一）成都士兰半导体制造有限公司

- 1、公司名称：成都士兰半导体制造有限公司
- 2、成立时间：2010 年 11 月 18 日
- 3、注册地址：成都-阿坝工业集中发展区内
- 4、注册资本：70,000 万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售；货物进出口。
- 7、股东情况：成都士兰为本公司之全资子公司，本公司持有成都士兰 100% 股权。
- 8、财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，成都士兰经审计的总资产为 79,153

万元，负债为 6,245 万元，净资产为 72,908 万元。2019 年营业收入为 18,499 万元，净利润为 1,708 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，成都士兰未经审计的总资产为 86,187 万元，负债为 12,175 万元，净资产为 74,012 万元。2020 年上半年营业收入为 9,439 万元，净利润为 1,104 万元。

(二) 成都集佳科技有限公司

1、公司名称：成都集佳科技有限公司

2、成立时间：2015 年 6 月 4 日

3、注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇土芯路 9 号 1 栋 1-3 楼（成都—阿坝工业集中发展区内）

4、注册资本：21,000 万元

5、法定代表人：范伟宏

6、经营范围：集成电路、半导体分立器件、功率模块等半导体产品的设计、制造、销售及相关技术转让；相关的原材料、机械设备的销售；货物进出口和技术进出口。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股东情况：集佳科技为成都士兰之全资子公司，成都士兰持有集佳科技 100% 股权。

8、财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，集佳科技经审计的总资产为 23,681 万元，负债为 9,268 万元，净资产为 14,413 万元。2019 年营业收入为 26,994 万元，净利润为-70 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，集佳科技未经审计的总资产为 29,153 万元，负债为 11,198 万元，净资产为 17,955 万元。2020 年上半年营业收入为 15,071 万元，净利润为 542 万元。

三、投资进展情况

公司于 2020 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同时董事会授权董事长陈向东先生及公司管理层办理增资、认缴及工商变更等相关事宜，具体增资情况如下：

1、成都士兰增加注册资本事项

成都士兰本次新增注册资本 11,000 万元，其中：本公司以货币方式认缴出资 11,000 万元（其中 10,000 万元为募集资金，1,000 万元为自有资金）。本次增

资及认缴完成后，成都士兰的注册资本由 70,000 万元变更为 81,000 万元，本公司仍持有成都士兰 100% 股权。

2、集佳科技增加注册资本事项

集佳科技本次拟新增注册资本 10,000 万元，其中：成都士兰以货币方式认缴出资 10,000 万元（皆为募集资金）。本次增资完成后，集佳科技的注册资本将由 21,000 万元变更为 31,000 万元，成都士兰仍持有集佳科技 100% 股权。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于提高公司资产质量，降低项目投资成本，促进募投项目顺利实施，有利于加快公司特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目的建设和运营，进一步提升公司制造工艺水平，增强盈利能力，提高综合竞争力。

五、其他说明

有关该事项的后续进展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日